

**关键指标**

- 频率范围：DC~22GHz
- 增益：16dB
- 输出 P<sub>1dB</sub>：14dBm
- 供电电压：+8V@60mA
- 芯片尺寸：2.96mmx1.22mmx0.1mm

**典型应用**

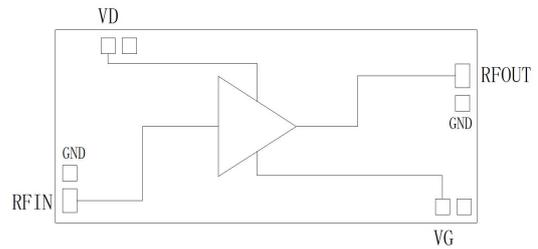
- 微波射频
- 卫星通讯
- 测试测量
- 光纤通信

**产品简介**

放大器 HX130510工作于 DC~22GHz, 采用GaAs 工艺制成, 在 60mA 工作电流下, 可提供16dB 增益, 14dBm 的输出 P<sub>1dB</sub>, 常温带内噪声低于 3dB。

该芯片采用了片上金属化工艺保证良好接地, 芯片背面进行了金属化处理, 适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

**功能框图**



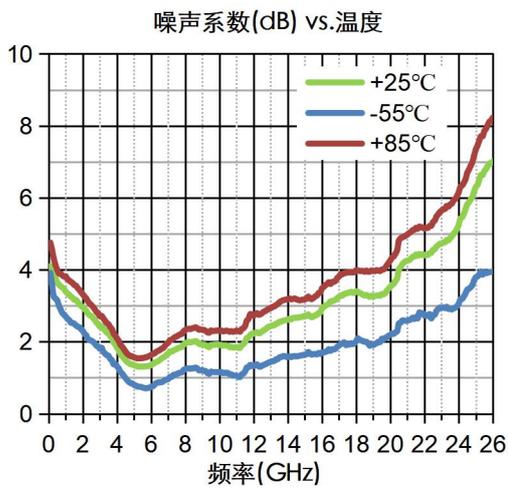
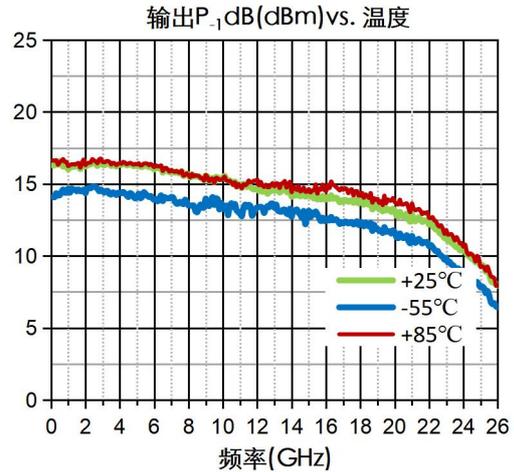
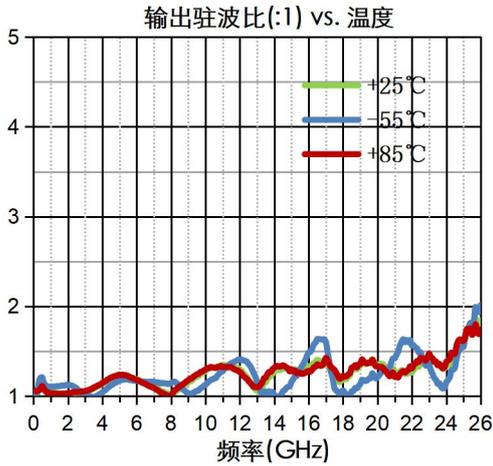
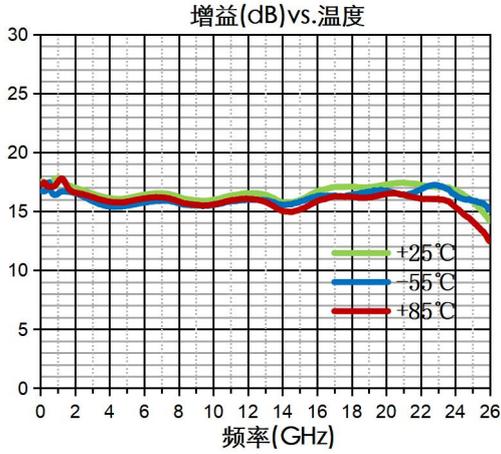
**电性能 (T<sub>A</sub>=25°C, V<sub>D</sub>=+8V, I<sub>D</sub>=60mA, Z<sub>0</sub>=50Ω)**

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	DC~22			GHz
增益	—	16	—	dB
输入驻波	—	1.3	—	:1
输出驻波	—	1.3	—	:1
噪声系数	—	3	—	dB
输出 P <sub>1dB</sub>	—	14	—	dBm
工作电流	—	60	—	mA

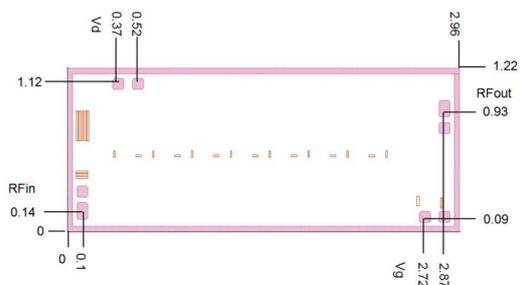
**绝对最大额定值**

最大输入功率	+5dBm	工作温度	-55°C~+85°C
沟道温度	150°C	贮存温度	-65°C~+150°C

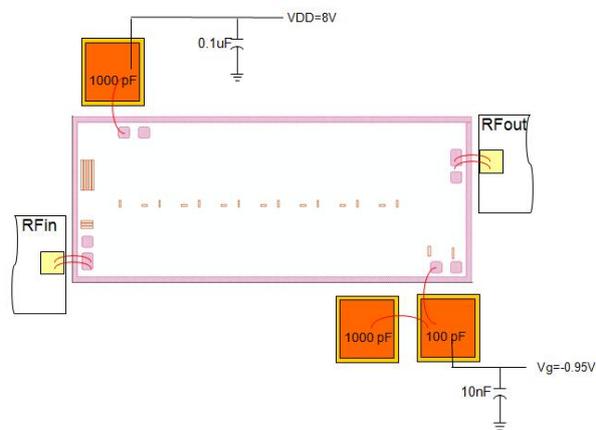
典型测试曲线



外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用  $\Phi 25 \mu\text{m}$  双金丝键合，建议金丝长度 250~400  $\mu\text{m}$ ；
5. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。